

**AT&S**Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft

Pressemitteilung

28/02/2012

„Hermes“-Konsortium tagt in Hinterberg

AT&S leitet Konsortium, um Miniaturisierung und Zuverlässigkeit voranzutreiben

Die Miniaturisierung speziell im Smartphonebereich bei einer gleichzeitig zunehmenden Zahl an Funktionalitäten und höherer Qualität ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Aufgabe des Konsortiums besteht darin, neue Technologien in der Miniaturisierung zu industrialisieren.

Im Frühjahr 2008 startete AT&S, führender Leiterplattenhersteller in Europa & Indien sowie einer der Top-Player weltweit, gemeinsam mit elf renommierten europäischen Global Playern aus Industrie, Automobil und Luftfahrt und aus verschiedensten Stufen der Wertschöpfungskette eines der größten von der EU geförderten Projekte.

„Hermes“ geht weit über die heutigen Verbindungsmöglichkeiten hinaus. Neben passiven Bauelementen, wie Widerständen und Kondensatoren, werden auch aktive Bauteile, wie Chips, in Serienproduktion in das Innere der Leiterplatten eingebettet. Dies schafft zusätzlichen Platz auf den Leiterplatten und steigert auf Grund effizienterer Verbindungsmöglichkeiten die Energieeffizienz und Produktlebensdauer.

Ein wesentliches Ziel dieses europäischen Projektes ist es, Industriestandards zu setzen und damit gegenüber dem asiatischen Wettbewerb einen Vorteil zu generieren. Mit der Industrialisierung dieser Technologie öffnet sich für die AT&S eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten, etwa im Medizinbereich - wie z.B. neue Generationen von Hörgeräten oder Herzschrittmachern - sowie in funktionellen Modulen, wie z.B. GPS, WLAN, Blue Tooth oder Kameramodule. AT&S stärkt damit auch bei den bestehenden Kunden die Position als Innovations- und Technologieführer und kann neue Lösungen anbieten.

Während der Laufzeit des Projektes gelang die Vermarktung der ECP® Technologie durch den Aufbau der Produktionslinie in Hinterberg. Die AT&S wurde mit dem „Fast Forward Award 2011“ für die ECP® Technologie ausgezeichnet. In den nächsten Jahren wird sich die Komplexität in und auf den Modulen weiterentwickeln und unter Nutzung der 3D Fähigkeit der Embeddingtechnologie die nächste Generation der mobilen elektronischen Geräte ankündigen.

Facts & Figures

HERMES: High density integration by Embedding chips for Reduced size Modules and Electronic Systems

Partner:

ASM Assembly Systems
Atotech
Bosch
Circuit Foil Luxembourg
Fundico
Infineon
RoodMicrotec
Thales Communications & Thales Corporate Services

Wissenschaftliche Partner:

Fraunhofer IZM
IMEC

Über Hermes

Vor vier Jahren wurde HERMES - ein von der Europäischen Kommission im 7. Rahmenprogramm gefördertes Projekt - gestartet. Zwölf Partner aus Industrie und industrieller Forschung bilden heute ein Konsortium mit der Aufgabe, die Chipembedding Technologie voranzutreiben und zu industrialisieren. Das Einbetten von Komponenten eröffnet neue Möglichkeiten zur Miniaturisierung von Schaltungen, wodurch der Flächenbedarf bzw. das Volumen verringert werden kann.

Die Entwicklung der Chipembedding-Technologie begann in Europäischen Konsortien bereits im Jahr 2000. Die Aufgabenfelder waren die Auswahl geeigneter Materialien, um Siliziumhalbleiter einzubetten und die Verbindungstechnik zum Chip zu entwickeln. Mit dem aufkommenden Interesse großer OEMs an der Chipembedding-Technologie wurde 2008 das Hermes Konsortium gegründet, um ein Industrialisierungsprojekt für Chipembedding durchzuführen. Nach vier Jahren kann das Konsortium auf eine erfolgreiche Umsetzung ihrer gesetzten Ziele blicken. Hermes ist ein von der Europäischen Kommission gefördertes Projekt und das erste, welches mit der Industrialisierung der Technologie beauftragt wurde. Das Konsortium ist als Supplychain organisiert.

Die Endkunden des Konsortiums kommen aus dem Automobil-, Industrie- und Sicherheitsbereich. Deshalb ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die Zuverlässigkeit und an die Chipembeddingtechnologie. Die realisierten Applikationen reichen von der Motorsteuerung über Powermodule für Industrieanwendungen bis zu Kommunikationsanwendungen im Sicherheitsbereich. Das Konsortium deckt alle Anforderungen zur Realisierung der Produkte ab.

Über AT&S

Die Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Insbesondere im höchsten Technologiesegment, den HDI-Microvia-Leiterplatten, welche vor allem in Mobile Devices zum Einsatz kommen, ist AT&S weltweit bestens positioniert. Erfolgreich ist der Konzern auch im Segment der Automotive-Leiterplatten sowie im Industrie- und Medizintechnikbereich tätig. Als internationales Wachstumsunternehmen verfügt AT&S über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring, Klagenfurt) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai) und Korea (Ansan nahe Seoul) und beschäftigt über 7.500 Mitarbeiter.

Weitere Infos auch unter www.ats.net

Presserückfragen:

Mag. (FH) Christina Schuller, Head of Corporate Communications
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
+43 3842 200-5908, c.schuller@ats.net